

公益社団法人砥粒加工学会 研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会
第 21 回 KENMA 研究会
【ブラシ/ファイバー法の可能性と難加工 SiC 基板の高エネルギー・高精度研磨法の追究】開催ご案内
主催：(公社)砥粒加工学会 研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会

2015年2月、(公社)砥粒加工学会に「研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会」が設立されました。本専門委員会では、「温故知新」の名言に倣い、研磨の歴史・ノウハウ・技術伝承の在り方を探り、そこから次代に向けた課題の明確化とその解決手法開発に取り組むことを目指します。第21回研究会を【ブラシ/ファイバー法の可能性と難加工 SiC 基板の高エネルギー・高精度研磨法の追究】と題して開催いたします。多数の皆様のご参加をお待ちしています。



日 時：2021年11月25日（木）13:30～16:20

開催場所：Zoom を用いてオンライン開催いたします。

内 容：

【テーマ：ブラシ/ファイバー法の可能性と難加工 SiC 基板の高エネルギー・高精度研磨法の追究】

13:30～13:35 開会挨拶 幹事 堀田和利 (株式会社フジミインコーポレーテッド)

13:35～16:20 話題提供

<技術講演>

1) 13:35～14:10 フレキシブルファイバー法によるウレタン並びにスウェード研磨パッドのコンディショニングと応用事例

昭和工業インターナショナル株式会社 専務取締役 新井雄太郎 氏

2) 14:10～14:45 セラミックファイバーブラシを用いた工作物の研磨について

株式会社ジーベックテクノロジー グローバルセールス&マーケティング部 吉原慎太郎 氏

14:45～15:05 休憩

3) 15:05～15:40 トライボケミカル研磨による SiC 基板の平坦化

熊本大学 大学院 自然科学研究部 准教授 久保田章亀 氏

<特別講演>

4) 15:40～16:20 陽極酸化を利用した大口径 SiC ウエハの高エネルギー電気化学機械研磨 (ECMP)

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター 招聘研究員 河田研治 氏

16:20～16:25 閉会の挨拶

幹事 小堀康之 (株式会社ハイテクノス)

参加費：3,000 円。事前振込みをお願い致します。

定 員：100 名 (先着順)

注意事項

- (1) 予稿集は PDF で配信いたします。
- (2) 参加申込み頂いた方には別途、事前振込みの請求書 (PDF ファイル) をメール返信でご案内をします。振込みが確認できましたら、Zoom のアドレスを配信させていただきます。
- (3) 原則、領収書の発行はございません。
金融機関発行の振込明細票等をもって領収書に代えさせていただきます。
- (4) 研究会は 13:30～開始しますが、Zoom の受付は 12:30～実施します。
- (5) 参加受付をして頂いた方のみ、Zoom ログイン (受付) できるようにします。
- (6) Zoom へのログイン名は【氏名 (所属)】としてください。
- (7) 研究会から配信した Zoom アドレスを他の方に転送される、ということはお避けください。
- (8) 録音・録画はお控えください。

参加申込〆切：2021年11月12日（金）

参加申込先並びに問合せ先：金沢工業大学 精密工学 (畝田) 研究室 KENMA 研究会事務局 竹澤瑛里子

TEL：076-274-8066 E-mail：unc-assi@neptune.kanazawa-it.ac.jp ※出来る限りメールでお申し込みください※

KENMA 研究会「第 21 回研究会」 参加申込書

| | | |
|-----|--------|--|
| 氏 名 | | |
| 勤務先 | | |
| 所属 | | |
| 連絡先 | 住所 | |
| | E-mail | |